**SanDisk闪迪2016校园招聘**

**公司简介**

SanDisk闪迪公司是全球领先的闪速数据存储卡产品供应商。公司由非易失性存储技术领域的国际权威Harari Eli博士在1988年创立。1995年11月，SanDisk成为了一家公开上市的公司，其纳斯达克股票代码为SNDK。2010年，SanDisk闪迪公司收入达到48亿美元。2011年SanDisk闪迪已成功跻身美国财富500强。公司总部设在美国加州硅谷，目前在全球范围内拥有超过8000名雇员。

SanDisk闪迪是闪存卡生产和销售领域的领导者，拥有全球大约三分之一的市场份额。是唯一一家有权制造和销售所有主要闪存卡格式的公司，包括Compact Flash®（CF）、SD、mini SD、Smart Media、Multi Media Card（MMC）、Memory Stick PRO和其它Memory Stick 产 品，以及SD-Picture Card和USB闪存驱动盘。SanDisk在闪存领域不断推陈出新，从2004年至今，先后推出Cruzer Titanium —全球最坚固的 USB 闪存盘及全球速度最快、性能最高的闪存卡 SanDisk Extreme III、内置 USB 连接功能的两用 SD 存储卡以及 Micro-SD — 世界上最小的存储卡等。

公司将为员工提供**优厚的**薪酬待遇、快节奏的工作环境和广阔的发展空间。在 SanDisk闪迪，我们相信企业社会责任（CSR）是企业整体成功的一个重要因素。这意味着采用道德层面及可持续的商业实践来指导我们的经商之道，同时重点关注相关利益人和环境利益。

**加入SanDisk，世界由你来存！**

**联系我们**

公司地址：上海市闵行区江川东路388号 **咨询邮箱**[staffing\_ncg@sandisk.com](mailto:staffing_ncg@sandisk.com)

****公司网址：<http://www.sandisk.com>

**2016校招网申二维码**

**（了解职位详情，即刻参与网申） SanDisk招聘二维码**

**招聘流程**

**9月中旬—10月29日**

**网申**

**10月上旬—10月下旬校园宣讲**

**10月中旬—11月上旬**

**第一轮面试**

**11月中旬**

**终面（开放日）**

**12月上旬**

**发放Offer**

**宣讲行程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **地点** | **学校** | **时间** | **地点** |
| **杭州** | **浙江大学** | **10月11日周日**  **9:30-11:30** | **（玉泉校区）**  **永谦活动中心第一报告厅** |
| **SanDisk  开放日（第一场）** | | **11月12日 周四 全天** | **上海市闵行区江川东路388号** |
| **SanDisk  开放日（第二场）** | | **11月17日 周四 全天** | **上海市闵行区江川东路388号** |

**申请途径**

**第一步—了解职位详情**

**扫描下方二维码，或 微信关注”SanDisk 招聘”点击人才招聘> University Hire关注**

**第二步—职位申请**

**了解职位后，微信中直接网申**

**或直接将简历投递至** [**staffing\_NCG@sandisk.com**](mailto:staffing_NCG@sandisk.com)**.**

**邮件主题：姓名+学校+专业+投递职位**



**职位简介—职位详情请扫描上方二维码**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职位名称** | **学历** | **专业** |
| **研发** | | |
| 测试开发工程师(芯片测试)  Test Development Engineer  (Memory Test) | 本科及以上 | 电子类/自动化/计算机/其他相关 |
| 测试开发工程师(系统测试)  Test Development Engineer  (System Test) | 本科及以上 | 电子类/计算机/其他相关 |
| 产品工程师(芯片测试)  Product Engineer(Memory Test) | 本科及以上 | 电子类/自动化/计算机/其他相关 |
| 产品工程师(系统测试)  Product Engineer(System Test) | 本科及以上 | 电子类/自动化/计算机/材料类/  其他相关 |
| 新产品封装开发  Packaging Dev Engineer | 硕士及以上 | 材料类/物理/高分子/电子类/  其他相关 |
| 封装研发工程师（基板工艺）Packaging Des Engineer | 本科及以上 | 材料类/化学类/其他相关 |
| 软件工程师  Software Engineer | 本科及以上 | 电子类/自动化/计算机/其他相关 |
| 封装研发工程师  Packaging Dev Engineer | 硕士及以上 | 微电子/材料类/其他相关 |
| **生产运营** | | |
| 工艺工程师（塑封）  Process Engineer (Molding) | 本科及以上 | 材料类/机械类/电子类/其他相关 |
| 工艺工程师（芯片贴装）  Process Engineer (Die Attach) | 本科及以上 | 材料类/机械类/电子类/其他相关 |
| 工艺工程师（计算机软件）  Process Engineer (Software) | 本科及以上 | 计算机类/软件类/其他相关 |
| 工艺工程师（芯片预处理）  Process Engineer (Die Prepare) | 硕士及以上 | 材料类/高分子/自动化/电子类/  其他相关 |
| 工业工程师  Industrial Engineer | 本科及以上 | 工业工程/其他相关 |
| 库存控制分析员  Inventory Control Analyst | 本科及以上 | 物流管理/其他相关 |
| 质量工程师  Quality Engineer | 本科及以上 | 计算机类/软件类/其他相关 |
| **财务** | | |
| 应收账款培训生  AR Accountant | 本科及以上 | 财务/会计 |
| 成本分析员  Cost Analyst | 本科及以上 | 财务/会计 |
| **销售** | | |
| 销售支持分析助理  Assoc Sales Ops Analyst | 本科及以上 | 统计学/数学/经济学类/其他相关 |
| **人力资源** | | |
| 招聘专员  Recruiter | 本科及以上 | 人力资源管理/心理学/语言类/  其他相关 |

**小伙伴们，赶紧扫描二维码，了解职位详情，把简历砸向我们吧！！！**